



2014年3月期

中間決算説明会

(第2四半期累計)

2013年11月22日

 **ワイエイシー株式会社**

(証券コード: 6298)

<http://www.yac.co.jp>



Contents

- 1. ご挨拶、中間決算の総括**
..... 代表取締役 社長 百瀬 武文
- 2. 2014年3月期中間連結決算の概要**
..... 管理本部 経理部長 古橋 博
- 3. 2014年3月期連結決算の見通し**
..... 代表取締役 社長 百瀬 武文
- 4. 質疑応答**



1. ご挨拶、中間決算の総括

..... 代表取締役 社長 百瀬 武文

- 前年同期比 減収・減益
- ハードディスク関連が激減
- 高精細パネル向け装置は堅調に推移
- 太陽電池・半導体関連は回復基調
- クリーニング関連は海外展開を強化し、
堅調に推移



2. 2014年3月期中間連結決算の概要

…………… 管理本部 経理部長 古橋 博

2-1 事業結果



(単位:百万円)

	2013年3月期 第2四半期 連結累計期間	2014年3月期 第2四半期 連結累計期間	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
売上高	10,924	8,329	▲2,594	▲23.8%
営業利益 (営業利益率)	360 (3.3%)	40 (0.5%)	▲320	▲88.8%
経常利益	292	82	▲209	▲71.7%
当期純利益	195	25	▲170	▲87.0%
1株当たり 当期純利益(円)	21.96	2.86	▲19.10	—
研究開発費	140	93	▲47	▲33.7%
設備投資額	55	22	▲32	▲58.7%
減価償却実施額	132	123	▲8	▲6.4%

2-2 事業別売上金額



(単位:百万円)

	2013年3月期 第2四半期 連結累計期間	2014年3月期 第2四半期 連結累計期間	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
ハードディスク関連	1,936	298	▲1,638	▲84.6%
液晶関連	6,750	5,967	▲782	▲11.6%
半導体関連	201	125	▲76	▲38.0%
太陽電池関連	507	374	▲133	▲26.2%
FEL関連	0	0	0	▲52.1%
精密熱処理関連	1,003	957	▲45	▲4.5%
クリーニング関連	523	606	83	15.9%
合計	10,924	8,329	▲2,594	▲23.8%

2-3 事業別受注金額



(単位:百万円)

	2013年3月期 第2四半期 連結累計期間	2014年3月期 第2四半期 連結累計期間	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
ハードディスク関連	903	563	▲340	▲37.7%
液晶関連	3,977	1,792	▲2,184	▲54.9%
半導体関連	250	211	▲39	▲15.9%
太陽電池関連	423	361	▲61	▲14.5%
FEL関連	0	0	0	▲52.1%
精密熱処理関連	966	1,366	399	41.3%
クリーニング関連	523	606	83	15.9%
合計	7,046	4,901	▲2,144	▲30.4%

* クリーニング関連は販売計画に基づいた見込み生産のため受注=売上となります。

2-4 事業別受注残高



(単位:百万円)

	2013年3月期 第2四半期 連結累計期間	2014年3月期 第2四半期 連結累計期間	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
ハードディスク関連	252	515	262	103.8%
液晶関連	3,455	1,593	▲1,861	▲53.9%
半導体関連	64	114	50	78.7%
太陽電池関連	393	230	▲162	▲41.4%
FEL関連	0	0	0	—
精密熱処理関連	1,016	525	▲490	▲48.3%
クリーニング関連	0	0	0	—
合計	5,181	2,979	▲2,202	▲42.5%

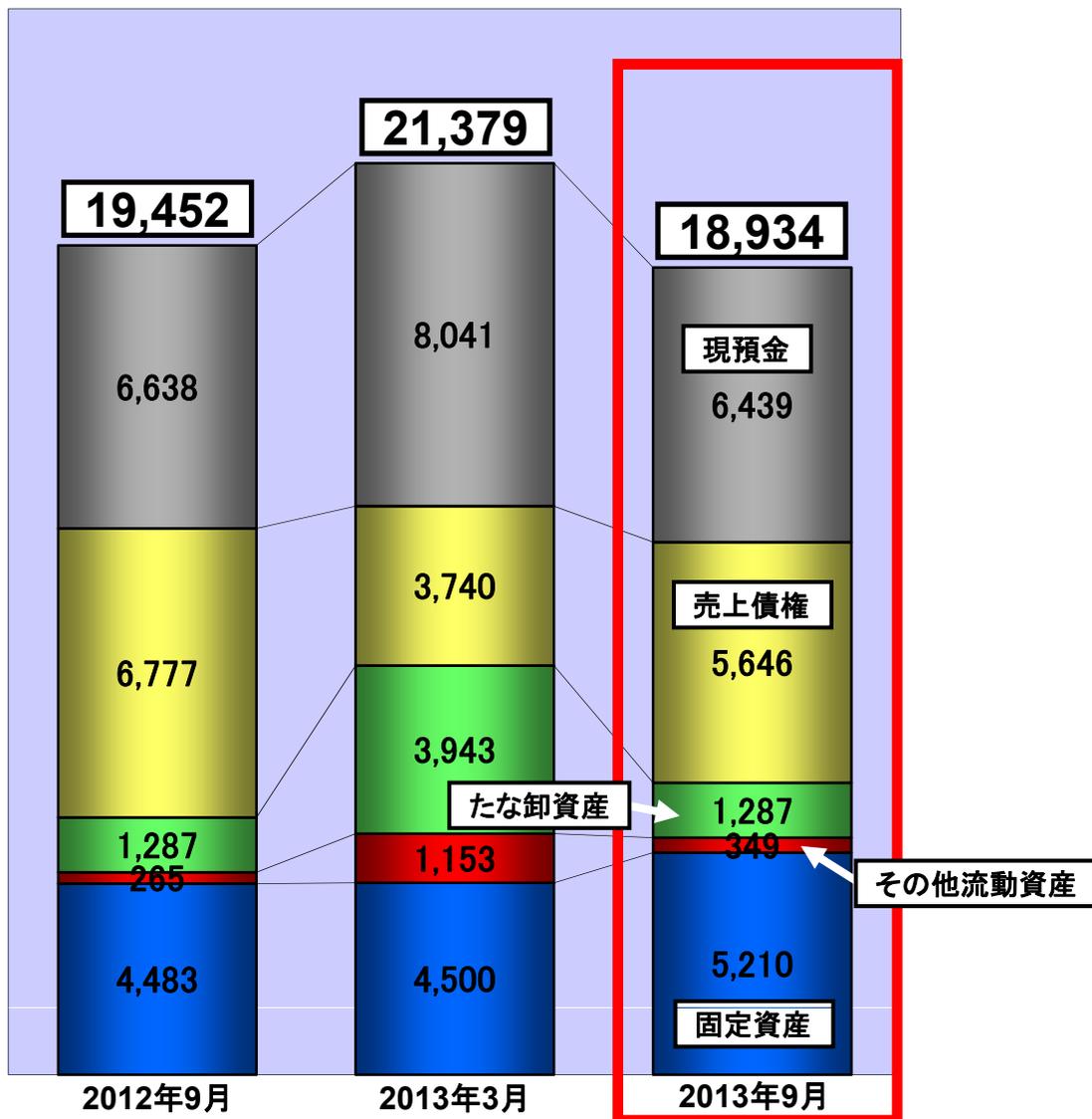
* クリーニング関連は販売計画に基づいた見込み生産のため受注=売上となります。

2-5 貸借対照表のレビュー



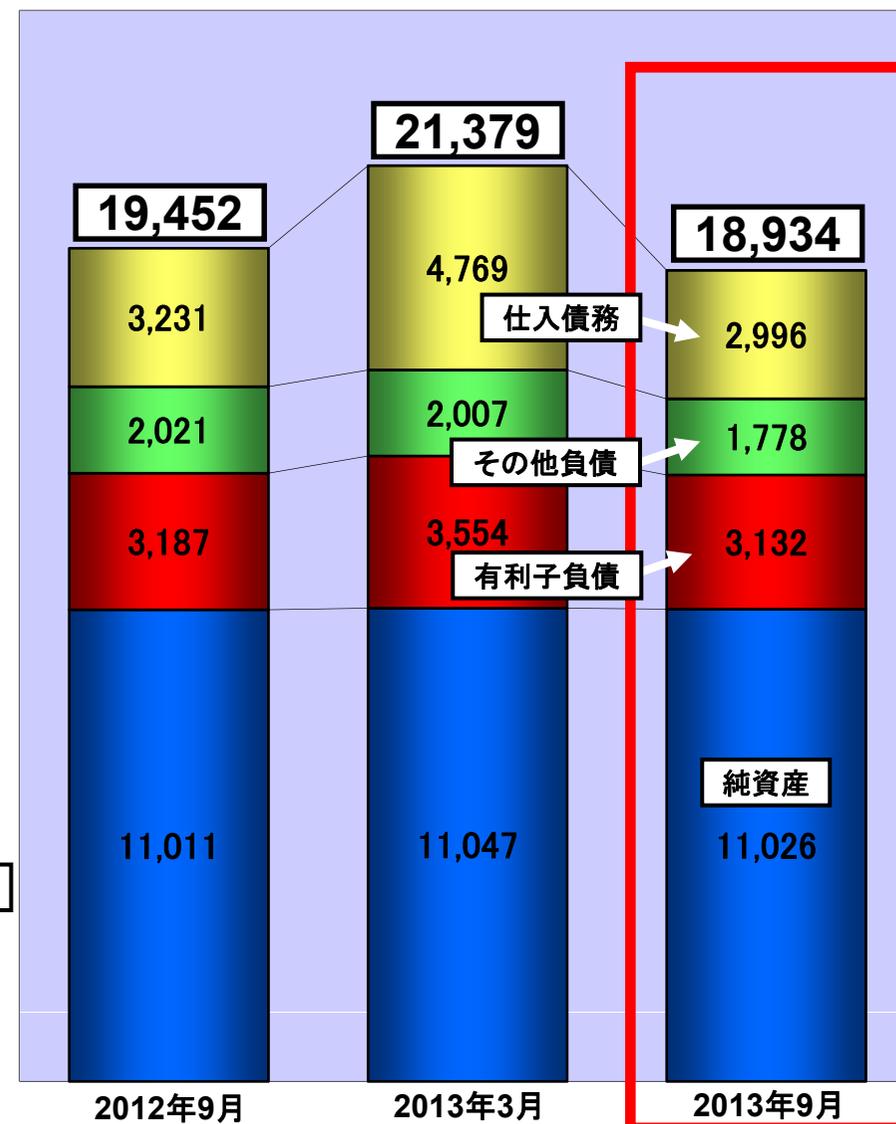
資産

(単位:百万円)



負債・純資産

(単位:百万円)



2-6 キャッシュフローのレビュー



(単位:百万円)

	2012年3月期 第2四半期 連結累計期間	2013年3月期 第2四半期 連結累計期間	2014年3月期 第2四半期 連結累計期間
営業活動によるCF	467	▲1,122	▲856
投資活動によるCF	462	▲65	▲830
財務活動によるCF	▲728	▲876	▲780
現金及び現金同等物の 期末残高	6,675	6,540	6,390



3. 2014年3月期連結決算の見通し

..... 代表取締役 社長 百瀬 武文

3-1 事業環境と重点施策



《ハードディスク関連》

- 2015年までは横ばい予測、海外メーカーは来年投資の見込み
- サブストレート業界への深耕
- ハードディスクで培った包装技術・搬送技術を他業界へ横展開

《液晶関連》

- 高精細パネル(4K2K)は中国を中心に中型から大型へ
- プロセス領域を更に拡大、高精細プロセスをカバー
- G8向けドライエッチング・ウエットエッチング・アニール装置投入

3-1 事業環境と重点施策



《半導体関連》

- 半導体の前工程は好調、今後、後工程も好転の予測
また、パワー半導体も底入れ感あり
- ロジック半導体・パワー半導体市場へハンドラーを中心に展開
- モジュールテスト工程向けに省力化装置を投入

《太陽電池関連》

- 低価格と高変換効率化が一段と進む
特に台湾は、米国・日本へ良質なパネルを供給すべく活況
- アジアを中心に高効率セル製造装置の販売強化
- 新配線装置を市場へ投入

3-1 事業環境と重点施策



《FEL(フィールドエミッションランプ)関連》

- 車載用ランプ、UVランプの商品化が進む

《精密熱処理関連》

- 部品軽量化が進む自動車業界、IGZOパネルの量産化
- ホットプレス関連、アニール装置の販売強化
- 金型予熱市場向け製品「ダイヒータ」の拡販

《クリーニング関連》

- 国内は成熟、発展途上国は市場が拡大
- リネン・ダスコン市場への販売強化
- 中国で生産・販売、欧・米市場へは新製品投入

■前年比 売上 : 横ばい
収益 : 減益

- ◎ハードディスク関連の激減により、業績を圧迫
- ◎客先の設備投資動向は増加基調にあり、下期より概ね回復の見通し

3-3 2014年3月期連結見通し



(単位:百万円)

	2013年 3月期	2014年 3月期 (見込)	前年比 増減額 (見込)	前年比 増減率 (見込)
売上高	14,868	15,000	131	0.9%
営業利益	245	200	▲45	▲18.6%
経常利益	309	230	▲79	▲25.6%
当期純利益	191	130	▲61	▲32.1%
1株当たり 当期純利益(円)	21.45	14.58	▲6.87	—

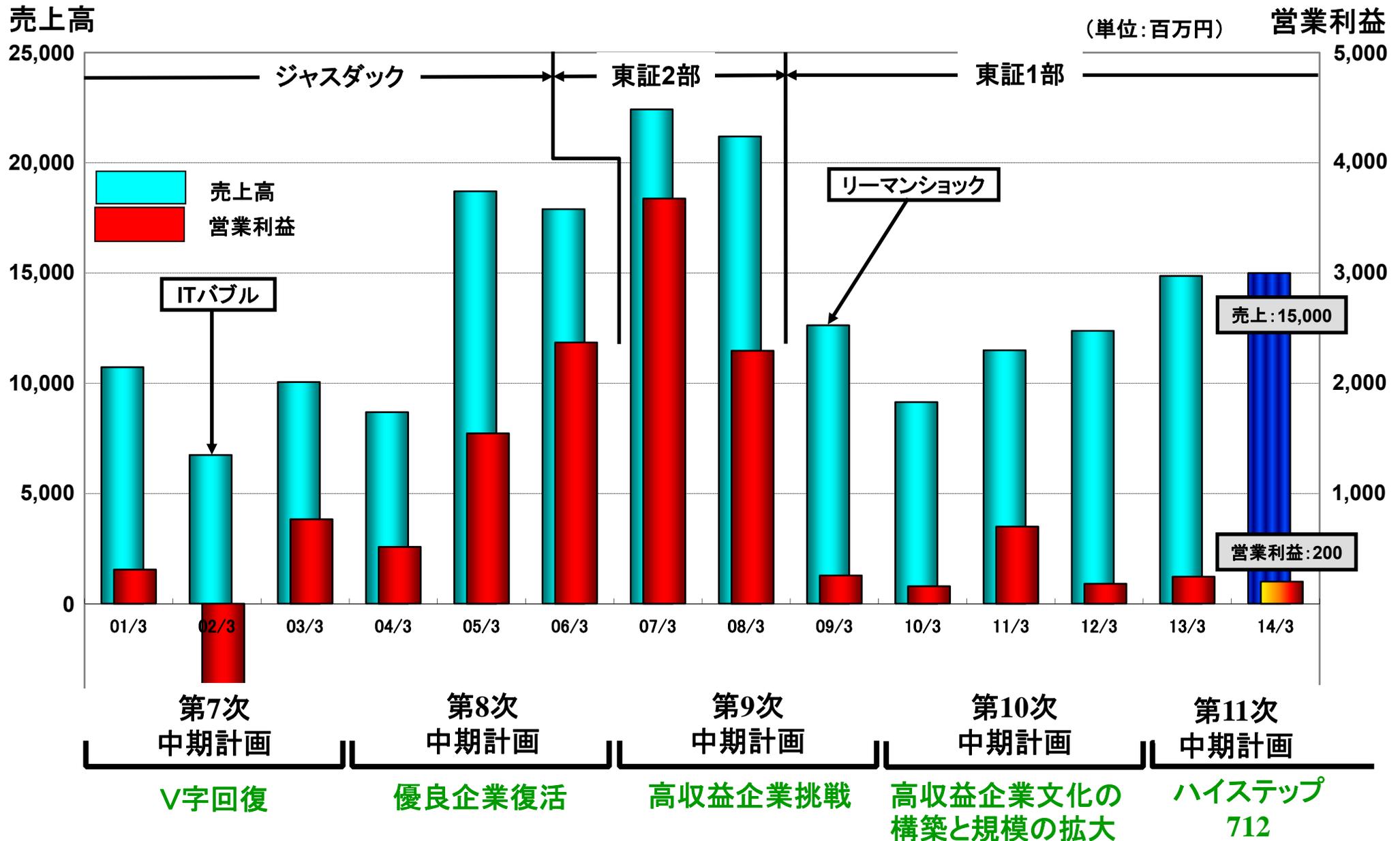
3-4 事業別売上見通し



(単位:百万円)

	2013年 3月期	2014年 3月期 (見込)	前年比 増減額 (見込)	前年比 増減率 (見込)
ハードディスク関連	2,812	900	▲1,912	▲68.0%
液晶関連	7,439	8,500	1,060	14.3%
半導体関連	359	700	340	94.8%
太陽電池関連	949	1,300	350	36.9%
FEL関連	0	0	0	—
精密熱処理関連	2,009	2,100	90	4.5%
クリーニング関連	1,297	1,500	202	15.6%
合計	14,868	15,000	131	0.9%

3-5 過去の業績と2014年3月期見込



4 新規事業への取り組み



- ロボット関連事業
- 蓄電池関連事業
- レーザー技術の応用
- プラズマ技術の応用
- 医療・介護関連機器



添付資料 ワイエイシイの概要

1. 基本情報
2. ワイエイシイの特徴
3. グローバルネットワーク
4. ワイエイシイグループの構成
5. 主力製品

1 基本情報



商 号	ワイエイシイ株式会社
証 券 コ ー ド	6298 (東証1部)
設 立	1973年(昭和48年)年5月
代 表 者	代表取締役社長 百瀬武文
事 業 所 等	本 社：東京都昭島市武蔵野3-11-10 営業所：大阪、昭島、新竹(台湾) 工 場：昭島、山梨、熊本、大分
グ ル ー プ 会 社	株式会社ワイエイシイデンコー(東京都青梅市) ワイエイシイ新潟精機株式会社(新潟県妙高市) YAC国際電熱株式会社(東京都昭島市) HYAC Corporation(米国カリフォルニア州) YAC Systems Singapore Pte Ltd(シンガポール) YAC KOREA CO.,LTD(韓国城南市) 瓦愛新(上海)国際貿易有限公司(中国上海市)
投 資 会 社	株式会社NDマテリアル
資 本 金	2,756百万円
事 業 内 容	エレクトロニクス関連装置、クリーニング関連装置の 開発・設計・製造・販売
決 算	3月31日

2 ワイエイシイの特徴



- 7分野の事業領域
- ファブレス
- M&A・アライアンス
- 製・販のグローバル化(アジアに注力)
- デバイス事業への参入
- 全員参加型経営(大討論会)
- 依命システム

3 グローバルネットワーク



● 本社・本社工場（東京都昭島市）

● テクニカルセンター（東京都昭島市）

● 株式会社ワイエイシイデンコー（東京都青梅市）

● YAC国際電熱株式会社（東京都昭島市）

● ワイエシイ新潟精機株式会社（新潟県妙高市）

● 山梨工場（山梨県南アルプス市）

● 大阪営業所（大阪府大阪市）

● 株式会社NDマテリアル（高知県高知市）

● 大分工場（大分県大分市）

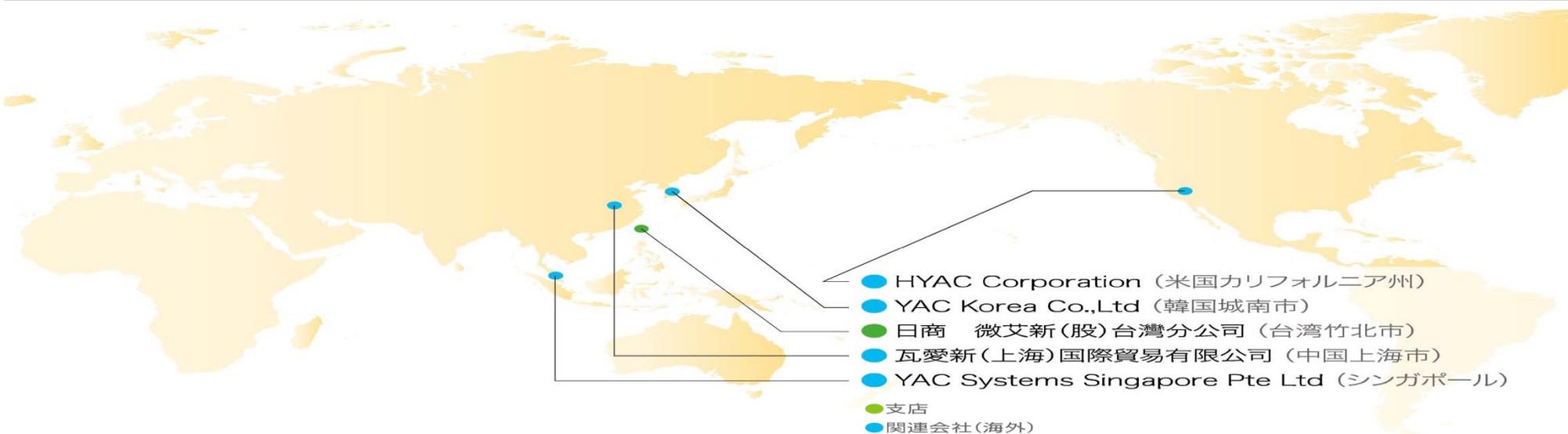
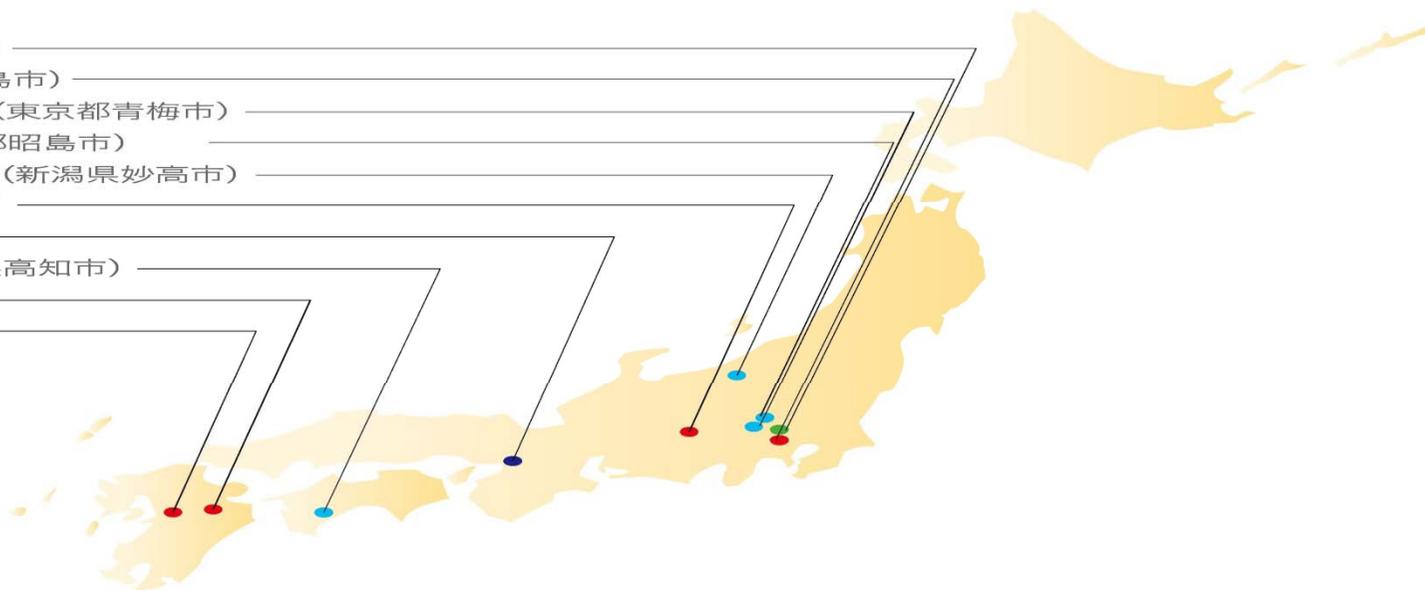
● 熊本工場（熊本県大津町）

● 本社

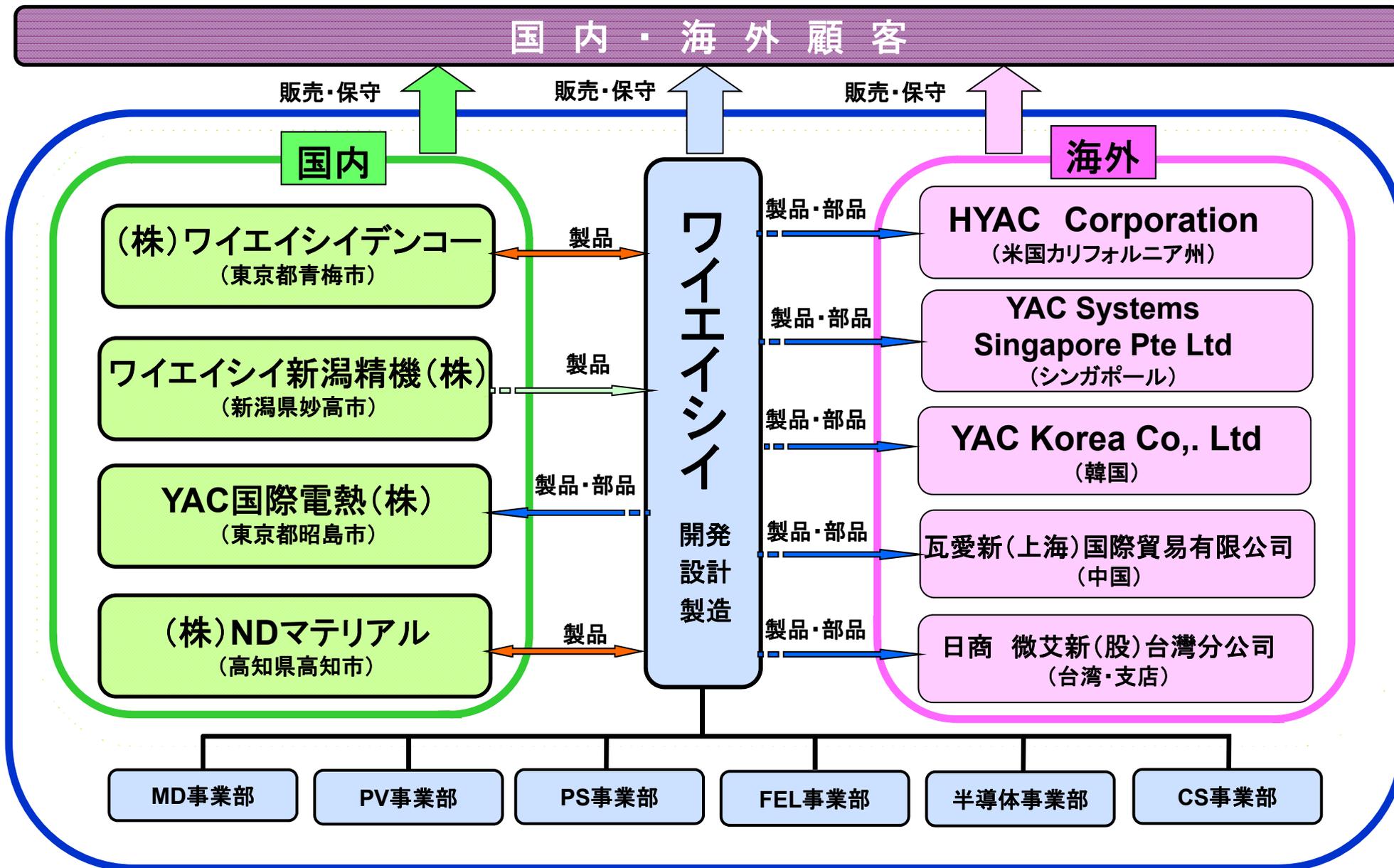
● 研究開発・生産拠点

● 販売・メンテナンス拠点

● 関連会社(国内)



4 ワイエイシイグループの構成



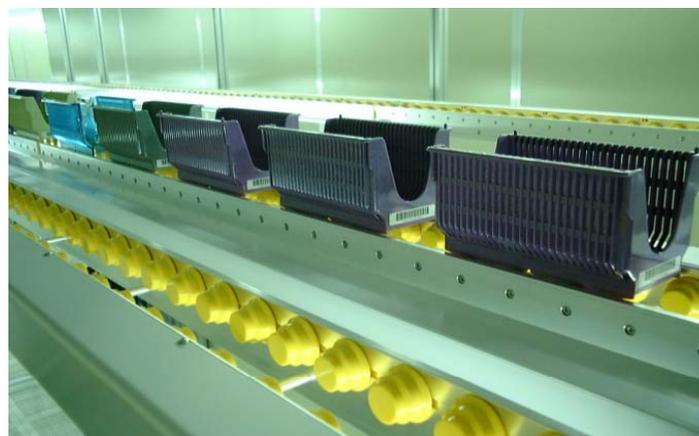
5-1 ハードディスク関連製品



バーニッシュ装置	ハードディスク製造工程において、ディスクに磁性体を生成後、表面のナノオーダーの微小突起を除去する精密研磨装置
ワイピング装置	ハードディスク製造工程において、ディスクに磁性体を生成後、バニッシュ工程の前後で、表面のパーティクルの除去及び潤滑財を表面に均一にする装置
UVキュア装置	基盤上の磁性膜面に潤滑剤(紫外線(UV)の波長に適合した潤滑剤が完成)を薄くなじませる装置
クリーンコンベア (HD工場向け)	モジュールの組み合わせで自由な搬送ライン設計が可能なローラー式コンベアAGV(自走型搬送ロボット)やOHT(天井架設型搬送装置)に比べ、搬送物をいつでも搬送ラインに投入することができ搬送効率が高い
クリーンコンベア (半導体工場向け、 太陽電池工場向け)	(同上)但し、半導体向けは搬送物が300mm用ウエハポット、太陽電池はガラス基板又は約5"ウエハーが入ったカセットで、ハードディスク用に比べコンベア幅大きく、より高い耐加重性、耐衝撃性、高速搬送が要求される
クリーンコンベア (液晶工場向け)	(同上)但し、搬送物はパネルサイズに切りだされた基盤を搬送する、ハードディスク用に比べコンベア幅大きく、より高い耐加重性、耐衝撃性、高速搬送が要求される



バーニッシュ装置



ハードディスク用クリーンコンベア



半導体用高速クリーンコンベア

5-2 液晶関連製品



プラズマドライエッチング装置	プラズマ技術を用いたドライエッチング装置 LTPS・OLEDといったスマートフォン向けの高精細加工をはじめとして、製造プロセスの効率化や省マスク技術、大型化などに最適
アニール装置	膜質の改質・改善をおこなうための熱処理装置 YHRシリーズは今後のLTPSスマートフォン・タブレットをターゲットとした高精細パネル製造に欠かせないRTA装置 LTPS高精細パネルの量産に適した装置性能を保持しており、スマートフォン・タブレットの更なる高性能化に寄与
バレル式アッシング装置	プラズマ技術を用いた国産初の半導体向けバッチ式アッシング装置 表面改質、滅菌分野など広範にわたり対応可能 PACKシリーズはポンプと発振器を専用ラックに収納可能な卓上タイプ



高密度プラズマドライエッチング装置



アニール装置 (YHRシリーズ)



バレル式アッシング装置
(PACKシリーズ)

5-3 半導体関連製品



ロジック系IC用 テストハンドラー	ICのパッケージ後の検査工程でテスターと接続して使用し、テスターからのテスト結果信号に基づきICを良品と不良品に自動選別する装置 必要に応じて精度の高い低温・高温(-55℃~155℃)下でのテストにも対応可能
ポゴピン挿入機	ポゴピンを使用したソケットの、ポゴピン交換を自動で行う省力化装置
半導体製造装置 及び 関連部品洗浄装置	<ul style="list-style-type: none"> ・半導体向けWET処理装置・・・洗浄装置、レジスト剥離装置、ナイトライド装置 ・半導体向け周辺設備・・・石英管洗浄装置、各種保管庫、薬液供給ユニット ・各種研究・開発用設備・・・手動処理装置、ドラフトチャンバー、スクラパー ・関連部品洗浄装置・・・脱脂洗浄装置



ロジック系ICテストハンドラー:C912 型
低・常・高温測定が可能なマルチタイプ、開発用に最適



ポゴピン挿入機



ロジック系ICテストハンドラー:A/H343 型
4個同時測定、常・高温タイプ、低振動、低発塵



石英管洗浄装置



手動処理装置



石英管保管庫



5-4 太陽電池関連製品



太陽電池(結晶・多結晶) 製造装置

単結晶・多結晶型太陽電池の全ライン(バッチおよびインライン方式)の製造装置

- ・テクスチャリング……………バッチ装置、インライン装置
- ・拡散炉……………チューブ式装置
- ・アイソレーション、PSGエッチング……………バッチ装置、インライン装置
- ・配線形成……………新配線形成技術
- ・その他関連装置……………手動処理装置



テクスチャリング装置



ISO/PSG装置



洗浄装置

5-5 FEL関連製品



ナノダイヤモンド薄膜製造

金属等の材料の表面に、ナノダイヤモンド膜でコーティングしたエミッターを製作
このエミッターを用いたフィールド・エミッション・ランプ(FEL)を試作

FELの特徴

- ・従来の蛍光灯と異なり、水銀・鉛等の有害物質を使用しない
- ・LED(発光ダイオード)に比べ発熱量が少なく、冷却を必要としない(効率が良い)
- ・長寿命である
- ・色選択の自由度が高い(白色から紫外領域まで)



試作品



試作品



発光写真

5-6 精密熱処理関連製品



<p>フラットパネルディスプレイ(FPT)用 加熱装置</p>	<p>液晶ディスプレイ製造用加熱装置MB・MSシリーズ、 液晶・OLEDディスプレイ製造用加熱装置MTシリーズ、 液晶ディスプレイ製造用ホットプレート式加熱装置、 液晶・OLEDディスプレイ製造用減圧乾燥装置、液晶用ウォーキングビーム式連続焼成炉</p>
<p>太陽電池関連装置</p>	<p>縦型ガラス基板加熱装置、薄膜太陽電池EVA架橋炉、縦型多段式拡散炉 ウォーキングビーム式連続乾燥炉</p>
<p>電子部品加熱装置</p>	<p>メッシュベルト搬送式連続炉(マッフル)、メッシュベルト搬送式連続炉(マッフルレス) ローラーハースキルン、電子部品用各種テスト炉</p>
<p>ヒーター及び関連機器</p>	<p>ラジアントパットヒーター (PD・GPD シリーズ) インフラ ユニ (BD・SG シリーズ) インフラ ユニットヒーター (PS・PU・PH・PM シリーズ) 各種ヒーター</p>
<p>自動車部品用加熱装置</p>	<p>自動車関連工業加熱装置(ハイテンション鋼板用)、金型加熱装置、金型予熱装置</p>



IGZO、OLEDアニール装置



金型予熱装置



ローラーハース式加熱炉



多段式加熱炉



自動車関連ハイテンション鋼板

5-7 クリーニング関連製品



ワイシャツプレス機	ワイシャツを熱板、熱風で仕上げる装置 襟とカフス、タックと袖、およびボディを3台の装置で仕上げる高速タイプはワイシャツプレス機の定番商品 タック、袖、ボディを一体で仕上げるボディースリーブタイプもある
ウール仕上機	ジャケット、ブラウス、パンツ、スカートなどを仕上げる装置
自動包装機	クリーニング完了後の衣類を自動で包装する装置 ハンガーにかけたまま包装する立体タイプと、畳んだ状態で包装する平面タイプがある
アパレル関連機械	洋服の生産工程、縮絨機(生地を蒸気で安定化させる)、芯地・接着機(裁断後の生地を張り合わせる) プレス仕上げ機(完成商品のシワを取り成型する)等、各種装置をラインナップ



全自動包装機 (立体タイプ)



ワイシャツ用ボディースリーブプレス機
(ダブルタイプ)



ジャケット・ブラウス仕上機



パンツ仕上機



さあ今日も、

ときめきと感動の日々であれ！

くまやか先端技術企業



ワイエイシー株式会社

数字の処理について

記載されている金額は百万円未満を切り捨て、その比率については小数第2位を四捨五入しています。

業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予測値と異なる可能性があります。

なお、第1四半期連結会計期間より在外子会社の収益および費用の換算方法の変更を行ったため、前年度数値は遡及適用後の数値に基づき算出しております。